

S6055

Das zuverlässige
High-speed System für die
automatische optische Inspektion
von Leiterplatten



AOI

High-speed Leiterplatteninspektion

Maximaler Durchsatz bei höchster Prüftiefe

**Skalierbare, modulare Sensorik,
je nach Prüftiefe und Durchsatz**

**Höchste Prüftiefe
bis zu 0201, 0,3 mm pitch**

Doppelspurbetrieb optional

**Standard- und Bleifrei-
Baugruppen**

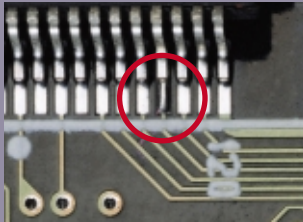
Leistungsstarke OCR-Software

**Schnelle Programmerstellung
mit EasyPro**

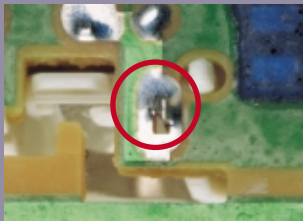
**Zusatzmodule:
Reparatur und Nachklassifikation,
Offline-Programmierung und
SPC-Auswertung**

**Weltweiter, kompetenter Service
vor Ort, per Hotline oder Fernwartung**

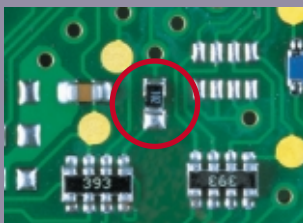
Internet-Support



QFP Auflieger



THT Benetzungsfehler



Chip Tombstoning



Dioden-Polarität

Die Entwicklung in der Elektronikproduktion ist gekennzeichnet durch zunehmende Miniaturisierung und steigende Qualitäts- und Durchsatzanforderungen. Bei der Suche nach geeigneten Yield-Management-Konzepten zeigt sich die automatische optische Inspektion (AOI) als ein entscheidender Ansatz. Sie gewährleistet nicht nur die schnelle und zuverlässige Inspektion der Baugruppen nach dem Löten sowie nach Pastendruck oder Bestückung, sondern bietet zugleich auch ein übergreifendes Prozessmanagement für die Fertigung.

S6055, die zuverlässige Inspektionslösung für Lötstellen, Pastendruck und Bestückung – von der effizienten Standardlösung bis zur Null-Schlupf-Strategie

Die S6055 arbeitet mit der leistungsstarken **4M-Sensortechnologie**, die auch bei extremen Taktzeitanforderungen höchste Prüftiefe garantiert. Zusätzlich gewährleistet der **Einsatz geneigter Kameramodule** die sichere Erkennung kritischer Fehler, z.B. Auflieger im fine-pitch Bereich. Zur weiteren Reduktion der Taktzeit ist ein **Doppelspurtransport** verfügbar.

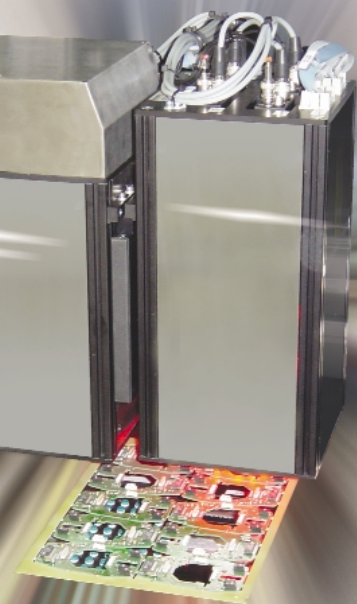
Mit **unterschiedlichen Systemvarianten** zeigt die S6055 die Flexibilität, die in der heutigen Fertigung gefragt ist. Je nach Prüfkonzept kann das System mit verschiedenen Typen und einer unterschiedlichen Anzahl von Kameramodulen individuell konfiguriert werden – von der effizienten Standardlösung bis zur Null-Schlupf-Strategie.

Die **Bedienoberfläche EasyPro** präsentiert sich übersichtlich und komfortabel. Programmerstellung und -optimierung können mit dieser Software einfach und schnell vorgenommen werden. Funktionen wie Auto-Optimierung, integrierte Schlupf-Verifikation und SPC-basierte Optimierung sind tragende Bestandteile von EasyPro und unterstützen das problemlose Einrichten neuer Produkte.

Nachgeschaltete Datenauswertung im Verbund mit der Viscom Nachklassifikation, SPC und EasyPro ergeben ein leistungsfähiges Werkzeug zur **Real-Time-Prozessoptimierung**.

Für Klarschriftlese-Aufgaben und Second-Source-Verifikation ist eine **leistungsstarke OCR-Software** erhältlich. Alle Viscom Systeme sind **100% bleifreitauglich** – dafür sorgt die algorithmenbasierte Auswertung, die auch bei unterschiedlichsten Kontrasten optimale Ergebnisse zeigt.

Anwenderbetreuung und Service mit Remote-Diagnose, Hotline und Vor-Ort-Service bieten individuelle und effiziente Unterstützung. Zusätzlich bietet unser Internet-Kundenforum kostenlose Prüfmuster-Downloads und aktuelle Informationen.



EasyPro - AOI Bedienung leicht gemacht

- Ausgewählte Datenquellen
- Aktuell aktive, selektierte Bauelemente
- Intuitive Bedienung
- Auto-Optimierung für validierte Ergebnisse
- Integrierte Verifikation durch die vom Reparaturplatz hinterlegten Echtfehler

Technische Daten

S6055

Inspektionsumfang

Lötstellen, Bestückung, Paste

Sensorik

Orthogonal-Sensormodul 4M-SR in 4M-Technologie

Bildfeldauflösung	1376 x 1024 bis zu 5504 x 4096 Pixel
Anzahl der Megapixelkameras	1 - 4
Bildpunktgröße	22 µm, 10 µm (optional)

Schrägsicht-Sensormodul MAV in 4M-Technologie (optional)

Bildfeldauflösung	1376 x 1024 Pixel, 4-fach oder 8-fach
Anzahl der Megapixelkameras	4 oder 8
Bildpunktgröße	15 µm

Software

Bedienoberfläche	Viscom EasyPro
SPC	Viscom SPC-Paket, offene Schnittstelle (optional)
Reparaturplatz	Viscom S6002 HARAN (optional)
Remote Diagnose	Viscom SRC (optional)
Programmierplatz	Viscom PST34 (optional)

Analyserechner

Betriebssystem	Windows 2000®
Prozessor	Intel PENTIUM® Prozessortechnologie

Leiterplattenhandling

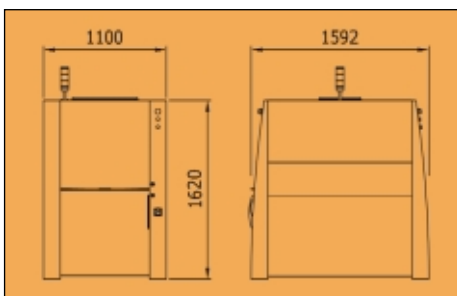
Leiterplattengröße	457 x 355 mm, 457 x 635 mm (optional) (L x B)
Leiterplattenunterstützung	(optional)
Transporthöhe	830 bis 960 mm ± 20 mm
Breitenverstellung	Automatisch beim Rüsten
Positioniereinheit	Gantry-System mit Synchron Linearmotoren
Doppelspurbetrieb	Mit internem und externem Shuttle (optional)
LP-Klemmung	Pneumatisch während der Prüfung
LP-Auflagebreite	3 mm
Obere Durchfahrtshöhe	35 mm
Untere Durchfahrtshöhe	50 mm

Prüfgeschwindigkeit

Typisch 20 - 40 cm²/s

Sonstige Systemdaten

Schnittstellen	SMEMA, SV70, kundenspezifisch
Anschlusswerte	400 V 50/60 Hz, 110 V/60 Hz (optional), < 3 kW, 6 bar Druckluft
Systemmaße	1100 x 1592 x 1620 mm (B x T x H)



Zentrale: Viscom AG

Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover · Deutschland
Tel.: +49-511-94996-0
Fax: +49-511-94996-900
E-Mail: info@viscom.de
<http://www.viscom.de>

Amerika: Viscom Inc.

3290 Green Pointe Parkway
Suite 400 · Norcross, GA 30092
Tel.: +1 (678) 966-9835
Fax: +1 (678) 966-9828
E-Mail: info@viscomusa.com
<http://www.viscomusa.com>

Asien:

Viscom Machine Vision Pte Ltd.
150 Kampong Ampat
#06-02A, KA Centre
Singapur 368324
Tel.: +65-6285-9891
Fax: +65-6285-9321
E-Mail: viscom@pacific.net.sg